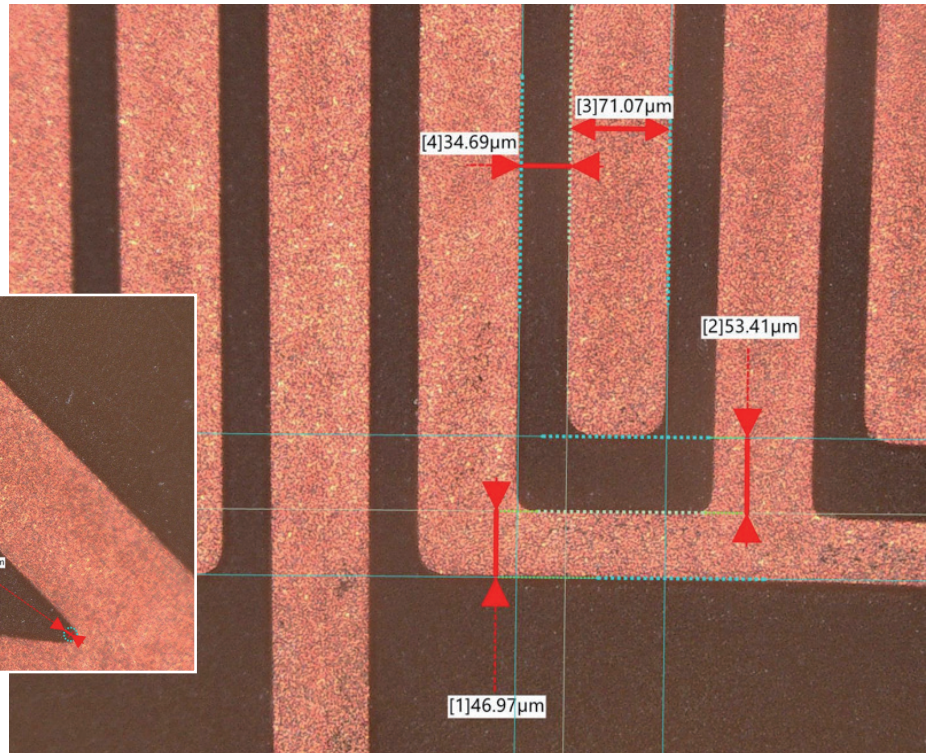
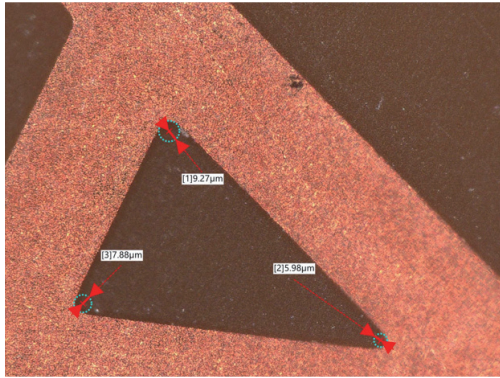


MSAP FPC

高密度



写真例

製品特徴

- 弊社 MSAP(Modified Semi-Additive Process)は、ポリイミド基材上に微細な銅配線を形成する高精度工法です。従来のサブトラクティブ工法に比べてエッチングによるパターン形状の乱れが少なく、より高密度な回路形成が可能です。
- 小型化高密度で微細配線が要求される FPC 用途に適しています。

比較表

	MSAP	サブトラクティブ
最小 L/S	30/30μm	50/50μm
精度	± 5μm	± 10μm (限定範囲)
導体厚み	5~20μm	5 ~ 19μm
基材	PI	PI、LCP
微細配線	適している	導体厚みによる



YAMASHITA MATERIALS